MICROCRE 研润光机

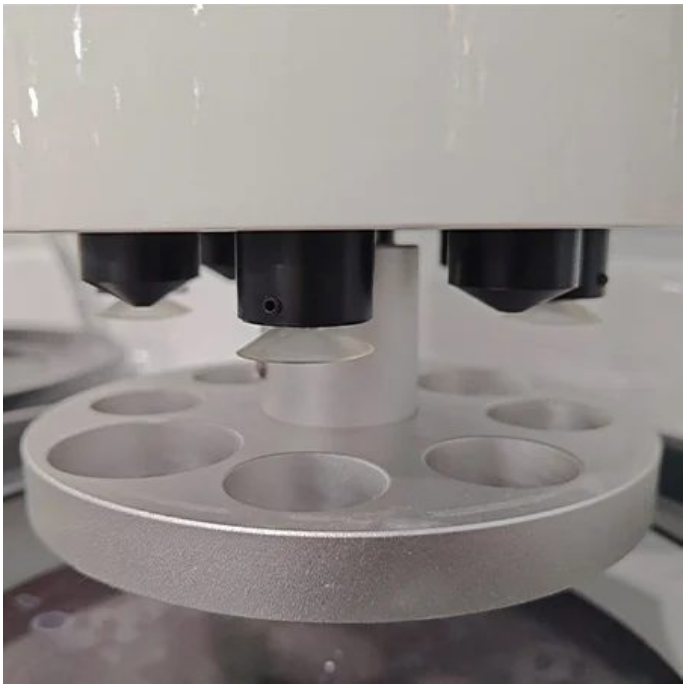
ZMP-2000Z 金相试样磨抛机

产品资料摘要

型号 ZMP-2000Z 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

台式双盘金相磨抛设备，结合触摸屏与PLC控制进行试样制备，支持中心加压或气动单点加压配置，适用于切割和镶嵌后的表面制备。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
类别	参数
型号	ZMP-2000Z
机体形式	台式双盘（磨头自动锁紧）
夹持数量	8个（30mm*6+40mm*2，特殊规格样件可定做）
磨抛形式	智能自动
加压方式	中心加压/（气动）单点加压

参数项目	原站列示数值或说明
控制方式	彩色触摸屏，PLC控制
操作系统	智能自动
磨抛转速	智能无极调速（50-1500转/分钟）
磨头转速	20-200转/分钟（自动调速）
磨抛方式	智能/自动/手动
磨样参数	智能存储，最多可存储 100 种磨抛方案
压力加载	自动加载，智能切换
磨料添加	双通道智能自动喷料
喷料时间	智能设定，最小喷料时间 0.1S
加料间隔	智能程控，最小加料间隔 0.1S

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZMP-2000Z.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。